

南茂科技股份有限公司

大學院校學生暑期實習合作計畫

一、目的：

為藉由學界技術與產業實務交流，強化優秀學子致力於半導體測試封裝領域相關學術研究與技術創新，南茂科技股份有限公司（下稱「南茂」）特設立本暑期實習合作計畫。

二、合作對象：

中原大學機械工程學系、化學工程學系、資訊工程學系、資訊管理學系

三、申請資格：應符合之條件如下

大三升大四生、大四升碩一生(繼續就讀中原大學研究所)及碩士班在學學生或系所專案推薦之學生。

四、申請期間：

自 2020 年 5 月 4 日起至 2020 年 5 月 15 日止，並於 2020 年 6 月 19 日通知審核結果。

五、申請方式：

1. 符合條件之申請者，應檢附書面資料如下：

(1).南茂應徵人員資料表正本一份

(2).學生證及身分證正反面影本各一份

(3).申請前一學年之成績單正本、獎懲證明，影本須加蓋教務處章

2. 送件方式：請掛號郵寄至「新竹市東區新竹科學園區研發一路一號 人力資源部 收」

六、實習內容：

期間：於 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日暑假期間，至南茂廠區進行實務工作實習二個月，接受部門職務技能訓練。

職缺：學生實習部門與職務內容以南茂公告開放職缺為主。本公司得依公司整體發展方向及業務需求，參酌學生的專長與意願進行任職單位分發，非有不可抗力之因素，學生應接受分發結果。如因對工作之地域有特殊需求之學生，可於申請表表明工作地域之需求。

地點：竹北一廠、竹科一廠

七、薪資福利：

薪資：給予優於法定基本工資之薪資水準。

工時：比照該職務之正職人員上下班時間

休假：依公司人事規章辦法規定

福利：

1. 享有勞保/健保/團保(限本人)
2. 享有勞退新制退休金
3. 享有與正職人員相同之內部專業訓練

八、審查方式：

開放進行報名後，由南茂進行資格初選及面談與核定。